

財團法人台灣設計研究院 函

地址：110台北市信義區光復南路133號
聯絡人：沈奕如
電話：(02)2745-8199 #334
電子信箱：yiju_shen@tdri.org.tw

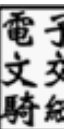
受文者：教育部

發文日期：中華民國111年6月22日
發文字號：台設字第1111001903號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：2022第三屆金點設計獎評選研習實作營招募簡章（1111001903-0-0.pdf）

主旨：檢送本院辦理第三屆「金點設計獎評選研習實作營」招募簡章，請惠予協助推廣並函轉各大專院校推薦參與，請查照。

說明：

- 一、金點設計獎為專業之華人設計獎項，自1981年創立於台灣，旨在褒揚傑出的創新設計，每年邀請國內外頂尖之設計及跨領域專家，遴選當年度優秀得獎作品。
- 二、旨揭研習實作營以金點設計獎、金點概念設計獎之評審會議為主軸，邀請對設計或本獎項有興趣及學習熱忱的學生全程參與評選過程觀察評審遴選與討論，學習透過大師視角解讀設計內涵與意義。
- 三、為持續深耕設計人才教育，今（111）年辦理第三屆研習實作營，細項說明如下：
 - （一）時間：110年9月19日（一）至9月26日（一）。
 - （二）地點：台灣設計研究院（台北市光復南路133號2樓，松山文創園區內）。
 - （三）招募人數：正取6名，備取3名。



(四)報名機制：由青年學子自行報名，可檢附老師推薦函，
報名至8月12日（五）截止。

(五)實作內容：參與金點設計獎、金點概念設計獎線上評選
會議，協助記錄評審評語及會後訪談，及參加設計講
座、工作坊等。

四、本院已同步行文相關設計院系旨揭研習實作營簡章，為利
推廣宣傳之效，爰請大部惠予轉知全國各大專院校，鼓勵
學子參與。

正本：教育部

副本：電交 2022/08/22 10:38:30 文章

